【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年4月15日(2010.4.15)

【公開番号】特開2009-123782(P2009-123782A)
【公開日】平成21年6月4日(2009.6.4)
【年通号数】公開・登録公報2009-022
【出願番号】特願2007-293581(P2007-293581)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/3205　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/304　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/88　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　21/88　Ｋ
Ｈ０１Ｌ　21/304　６２１Ｄ
Ｈ０１Ｌ　21/304　６２２Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月1日(2010.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
実施例においては、有機膜を凹部に埋め込むにあたって第１のベーク、ＣＭＰ、および第２のベークが行なわれるので、第２の有機膜の膜厚バラツキは１０ｎｍ未満に低減されることが、上記表６に示されている。このように、平坦性の改善が可能である。実施例１７のように２段階で研磨を行なった場合には、平坦性はさらに高められて、膜厚バラツキは５ｎｍ未満に低減される。しかも、実用的な速度で、有機膜前駆体を研磨することができる。